



kingston.com/epop

ePoP

ePoP - Gói nhúng trong bộ nhớ gói dành cho các thiết bị đeo

Bộ phận ePoP của Kingston là một thành phần chuẩn JEDEC có tính tích hợp cao, kết hợp bộ lưu trữ của Thẻ đa phương tiện nhúng (e-MMC) với Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên tiêu thụ điện năng thấp (LPDDR) DRAM vào giải pháp Bộ nhớ gói (PoP). ePoP được gắn trực tiếp trên máy chủ tương thích của Hệ thống trên một vi mạch (SoC), giúp giảm không gian Bảng mạch in (PCB) và đảm bảo hiệu suất tối ưu. ePoP là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng bị hạn chế về không gian, ví dụ như thiết bị đeo.

LỢI ÍCH CHÍNH

- Bằng cách gắn trực tiếp lên đầu SoC máy chủ, ePoP cung cấp giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng kích thước nhỏ như thiết bị đeo.
- Thiết kế hệ thống được tối giản, giảm thời gian đưa ra thị trường và rút ngắn chu kỳ kiểm tra chất lượng.
- DRAM công suất thấp và chương trình cơ sở lưu trữ được tối ưu hóa giúp giảm mức tiêu thụ điện năng trong khi vẫn mang lại hiệu suất cao cần thiết cho các ứng dụng cho thiết bị đeo chạy bằng pin.
- Có sẵn nhiều cấu hình phần lõi để đáp ứng các yêu cầu của bạn về ứng dụng như hiệu suất, sức mạnh và tuổi thọ.

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG



IoT



Thiết bị đeo



Thiết bị Thực tế tăng cường (AR)/Thực tế ảo (VR)

MÃ SẢN PHẨM VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA EPOP

ePoP dựa trên LPDDR3

Part number	Capacity		Standard		Package	FBGA	Operating temperature
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
04EP04-N3GM627	4	4	5,0	LPDDR3	10x10x0,8	136	-25°C ~ +85°C
04EP08-N3GM627	4	8	5,0	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C
08EP08-N3GTC32*	8	8	5,1	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C
32EP08-N3GTC32	32	8	5,1	LPDDR3	10x10x0,85	136	-25°C ~ +85°C

ePoP dựa trên LPDDR4x

Part number	Capacity		Standard		Package	FBGA	Operating temperature
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(mm)		
08EP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
08CP08-M4ETC32*	8	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,85	144	-25°C ~ +85°C
16EP08-M4ETC32	16	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP08-M4ETC32	32	8	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
16EP16-M4FTC32	16	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32EP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,8	144	-25°C ~ +85°C
32CP16-M4FTC32	32	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,85	144	-25°C ~ +85°C

*Chế độ pSLC cho độ bền cao hơn